

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-017

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	高盛(亚洲)有限责任公司 张博凯、郭劲、郑宇评、罗伊琳、宋婷、赵云蔚、吴雨鹤
时间	2021 年 7 月 13 日下午 14:00-15:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理、董事会秘书：张阿斌
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分： 上市公司介绍了赛微电子的发展历程以及最新动态，近年来，面向万物互联与人工智能时代，赛微电子已形成以半导体为核心的业务格局，MEMS、GaN 成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务。与此同时，公司围绕相关产业开展投资布局，服务主业。基于业界顶级专家工程师团队、所掌握的成熟工艺以及持续扩张的 MEMS 领域先进的 8 英寸产能，赛微电子积极把握市场需求，为全球客户提供高标准的 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造服务；同时基于业界顶级技术团队及优异的产品性能，积极快速地布局 GaN 产业链，面向新型电源、智能家电、通讯设备、数据中心等领域提供 GaN（氮化镓）外延材料、GaN 器件及配套应用方案。赛微电子执行长期发展战略，致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。

	第二部分：上市公司解答提问，主要提问及解答如下： 1、请问贵公司瑞典产线产能情况如何？瑞典产线 MEMS 业务毛利率情况如何？北京产线是否能达到瑞典的毛利率水平？预期将来会如何变化？ 答：自并购完成后公司便积极支持瑞典产线升级及持续扩产。瑞典产线在 2017-2020 年进行了超过 3 亿元人民币的资本投入，2020 年 9 月，瑞典原有 6 英寸产线（FAB1）升级切换成 8 英寸产线，原有 8 英寸产线（FAB2）亦已完成扩产，合计 MEMS 晶圆产能提升至 7,000 片/月的水平，产能在 2019 年末的基础上继续提升了 30%，且目前因重点客户需求仍在持续进行资本投入。 2020 年公司瑞典产线 MEMES 业务综合毛利率接近 50%，净利率接近 30%，预计现在和未来仍将维持在较高水平；北京 MEMS 产线由于是新建产线，存在较大的折旧摊销压力，且预计晶圆制造业务将在收入结构中占据较大比重，收入的产品结构也将不同于瑞典，因此北京 FAB3 运营初期的毛利率和净利率将低于瑞典产线；随着体量的增长，公司 MEMS 业务的整体毛利率预计将有所下降（但仍可以保持芯片代工行业的正常水平）。 2、请问贵公司 MEMS 芯片晶圆价格的变化趋势如何？其中哪一类晶圆的价格最高？哪一类晶圆的价格最低？北京产线的晶圆价格未来将达到什么水平？ 答：近年来，公司 MEMS 工艺开发与晶圆代工产能一直比较紧张，订单排期较长，从芯片晶圆单价的计算结果来看，近几年单片晶圆价格的上涨是持续且快速的，2017-2020 年公司 MEMS 晶圆的平均售价分别约为 1700 美元/片、1800 美元/片、2200 美元/片及 2700 美元/片；其中工艺开发晶圆的单价远高于晶
--	---

	圆制造，2020 年的均价约为 5500 美元/片，部分产品可超 1 万美元/片；根据产品类别，消费电子 MEMS 晶圆的平均售价较低，而生物医疗 MEMS 晶圆的平均售价较高，但在各类别晶圆中均存在高低不同的分布。与瑞典产线一样，北京产线的 Wafer 售价也会因不同类别而存在较大差异，与此同时，处于晶圆制造（量产）阶段的产品价格一般低于工艺开发（中试）阶段。 3、请问瑞典 ISP 如果未通过，是否会对北京产线的运营产生较大影响？ 答：公司在完成对瑞典 Silex 的收购之后即陆续推动瑞典 MEMS 产线与北京新建 MEMS 产线之间的技术交流与合作，双方在 2018 年即签订了相关技术服务与专利授权协议，由瑞典 Silex 为北京产线提供服务，授权使用技术。公司收购瑞典 Silex 股权及后续赛莱克斯北京与瑞典 Silex 开展技术合作的过程中，并无瑞典法律法规对此进行明确限制或瑞典政府部门要求进行审查或限制，上述股权收购及技术合作的相关协议文本在定稿签署前均咨询过瑞典当地律师的意见并经过其确认符合相关法律法规。但于 2020 年 10 月，瑞典 ISP（战略产品检验局）出具了一项决定，要求瑞典 Silex 取得出口授权许可才能将某些两用物项相关的技术出口到赛莱克斯北京。瑞典 ISP 出具决定的法律依据是《两用物项条例》第 4 条中的“兜底条款”，该条款授予瑞典 ISP 自行评估判断出口技术是否可被视为两用物项的权利。虽然瑞典 Silex 与赛莱克斯北京之间的技术合作内容并未在《两用物项条例》的两用物项清单中，且瑞典 Silex 与赛莱克斯北京之间的技术合作为瑞典 Silex 提供技术服务和专利授权，并非进行“无形资产”转让行为，但瑞典 ISP 依然有权决定瑞典 Silex 与赛莱克斯北京之间的技术交流与合作需要获得许可。 公司瑞典子公司 Silex 自 2020 年 11 月向瑞典 ISP 提交许
--	--

	可申请后持续跟踪动态，此前预计可以在今年 5 月底前取得最终结果，但该时间属于公司当地顾问所提供的参考预计时间，并非瑞典 ISP 承诺的办理完结时间，公司希望能够尽快取得是否授予许可的最终结果，但目前仍需要继续等待瑞典 ISP 的通知，由于是一国政府部门行为，需以其最终正式通知为准。公司北京 FAB3 与瑞典 FAB1&2 的技术与人员交流已进行数年，FAB3 自身也早已组建国际化工艺及制造工程师团队、投入大量工艺技术研发、并积极与战略客户开展技术合作，持续沉淀自主专利及工艺技术，FAB3 的生产运营不以瑞典 ISP 的许可为前提条件，也已在 6 月启动量产了首款 MEMS 芯片产品，但瑞典 FAB1&2 毕竟拥有 20 年的实践积淀，该许可若通过则将为北京 FAB3 更好更快地运营带来诸多有利因素。 4、请问贵公司北京产线资产的折旧摊销压力如何？产能达到多少才能实现盈亏平衡？ 答：在产线折旧摊销方面，对于公司北京 MEMS 产线（FAB3）的固定资产折旧政策，公司严格按照财政税务部门的相关政策和行业惯例执行，机器设备方面公司目前选择按 10 年进行折旧，厂房按照 20 年进行折旧，北京 MEMS 产线的相关资产已从 2020 年 10 月转固并按会计准则规定计提折旧。根据 FAB3 截至 2020 年末的资产情况（不考虑新添设备），静态预计每年归母折旧金额约在 6000 万元-7000 万元区间。随着后续产能的扩张建设，该金额将相应增长。同时考虑到工厂运转及人员费用，根据我们的内部测算，预计产能在 5000-10000 片之间是 FAB3 可以实现盈亏平衡。 5、请介绍贵公司北京 MEMS 代工产线的目前的产能情况，以及未来的产能计划？ 答：公司北京 MEMS 产线的建设总产能为 3 万片/月，目前一期
--	--

	产能 1 万片/月已建成，2020 年 Q4 内部调试，今年 Q1 开始晶圆验证，今年 6 月 10 日实现正式生产，今年下半年预计实现 50%的产能，即月产 5000 片晶圆，2022 年实现一期 100%的产能，即月产 10,000 片晶圆；2023 年实现月产 1.5 万片晶圆，2024 年实现月产 2 万片晶圆，2025 年实现月产 2.5 万片晶圆，2026 年实现月产 3 万片晶圆。随着北京产线工艺制造水平的逐渐成熟，若订单及客户需求的增长超出预期，则上述自 2022 年起的产能爬坡进度有可能加快。 6、请问贵公司北京 MEMS 产线目前的客户合作情况？ 答：2020 年 9 月底，公司北京 MEMS 产线建成并达到投产条件，此后，北京 MEMS 产线结合内部验证批晶圆的制造情况，持续调整优化产线，与客户开展产品验证，并继续做好人员、技术、工艺、生产、保障等各方面的工作。自开始建设起，公司北京 MEMS 产线便与瑞典产线以及国内潜在合作客户开展技术与产品的预热交流。2021 年 6 月 10 日，北京 MEMS 产线代工的首批 MEMS 麦克风芯片通过客户通用微（深圳）科技有限公司（GMEMS）的认证，正式启动量产。此外，公司北京 MEMS 产线自建成通线以来积极与通信、消费电子、工业汽车、生物医疗等领域客户沟通具体需求、合作协议并推进工艺及晶圆验证，且已经与部分客户签署并逐步开始履行商业合同，因涉及商业机密及保密义务，部分客户的具体信息公司不便告知。 7、请问贵公司在 MEMS 业务的竞争优势主要体现在哪些方面？ 答：公司在 MEMS 芯片工艺开发及晶圆制造方面已经深耕二十年，存在着显著的竞争优势，主要如下：（1）突出的全球市场竞争地位；（2）先进的制造及工艺技术，掌握了多项在业内极具竞争力的工艺技术和工艺模块；（3）标准化、结构化的工艺模块；（4）覆盖广泛、积累丰富的开发及代工经验；
--	--

	(5) 产业长期沉淀、优秀且稳定的人才团队；(6) 丰富的知识产权；(7) 中立的纯晶圆厂模式；(8) 前瞻布局、陆续实现的规模产能与供应能力。 8、请问贵公司在氮化镓（GaN）业务方面的产能情况如何？氮化镓业务的整体布局是如何考虑的？ 答：在 GaN 外延片方面，公司已建成的 6-8 英寸 GaN 外延材料制造项目（一期）的产能为 1 万片/年，目前已签订千万级销售合同并根据商业条款安排生产及交付。在 GaN 器件设计方面，产能主要受到供应方制造商产能的限制，目前在技术、应用及需求方面是没问题的，关键在产能供应端受限，在这方面公司已对外签订了批量流片合同，努力缓解产能瓶颈问题。另一方面，公司 GaN 业务子公司聚能创芯参股投资设立青州聚能国际半导体制造有限公司，目标是在 2021 年内建成 GaN 产线并做好投产准备，以尽快推动产能建设，完善 IDM 布局，进一步形成自主可控、全本土化、可持续拓展的 GaN 材料、设计及制造能力。 9、请问贵公司作为一家专业代工厂商，如何看待当前半导体行业产能供需紧张的状况？预计将持续多长时间？ 答：当前 MEMS 芯片代工在整个半导体芯片代工中仍属于一个较小的分支领域，我们作为该领域的厂商之一难以预测整个半导体行业的产能供需状况。从整体情况看，MEMS 芯片代工领域的产能也较为紧张，但并未达到非常夸张的程度。MEMS 芯片代工的需求取决于在物联网与人工智能时代下游应用的传导，不同类别 MEMS 芯片的诞生与成熟应用需要一个不同的过程，我们判断传感器的芯片化（即实现传感器件的微小化、低成本化、低功耗化）会是一个长期的发展趋势，尤其在国产替代背景下，本土代工厂商面临着一个机遇较好、持续存在的发
--	--

	展窗口。 10、公司当前正在布局 MEMS 封测，未来一颗 MEMS 芯片的成本将会如何分布？ 答：制造端与封测端的资本开支需要设计端及应用端的支持。从 MEMS 产业链当前的发展阶段来说，由于下游芯片的诞生和应用仍属于点状、尚未呈现全面爆发态势，因此在多品种、大多数类别小批量的背景下，由于规模效应未得到充分发挥，芯片制造与封装测试相比芯片设计占据了更高的价值份额，设计端占了约 30%-35%，制造端占了约 25%-30%，封测端占了约 35%-40%。但根据我们自身的判断，随着整个产业的持续发展，产业链的价值分布将与 IC 领域趋同，制造与封测环节厂商也将出现优胜劣汰，头部厂商将更为受益。在 MEMS 行业，芯片制造与封装测试的工艺边界正在变得越来越模糊、出现互相延伸与拓展的现象。以我们公司为例，在提供 MEMS 芯片制造的同时，在可选清单内也可以为客户提供晶圆级测试服务，且服务价格较为可观（最终一并反映在晶圆售价中）。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 7 月 13 日